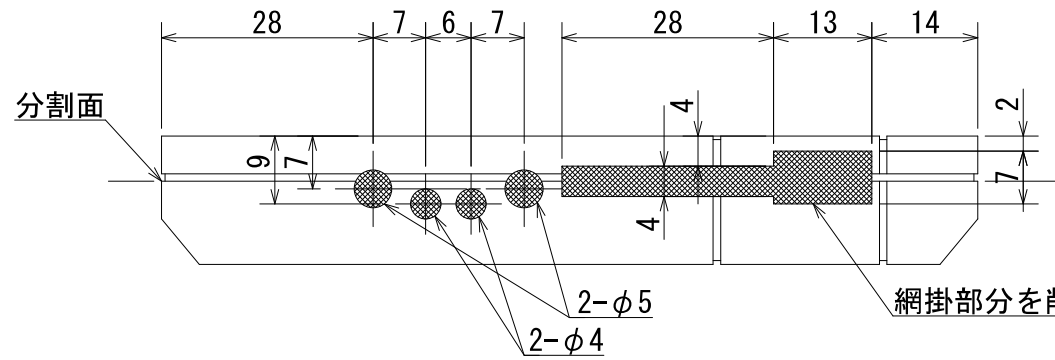


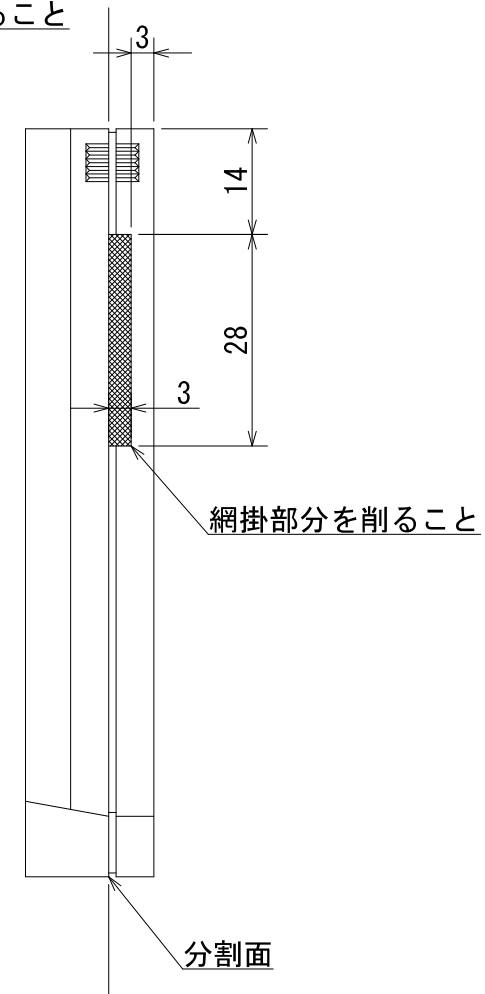
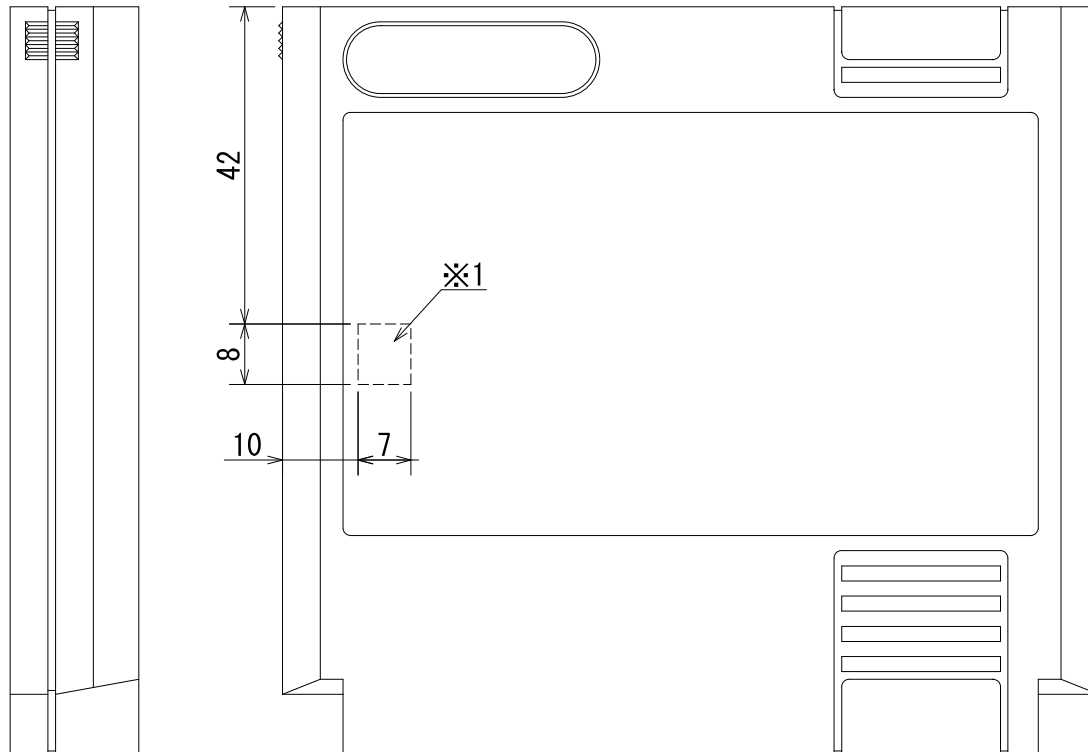
TNS-HFC3組込用カセット加工図

(単位: mm)

【外形加工図 ①】



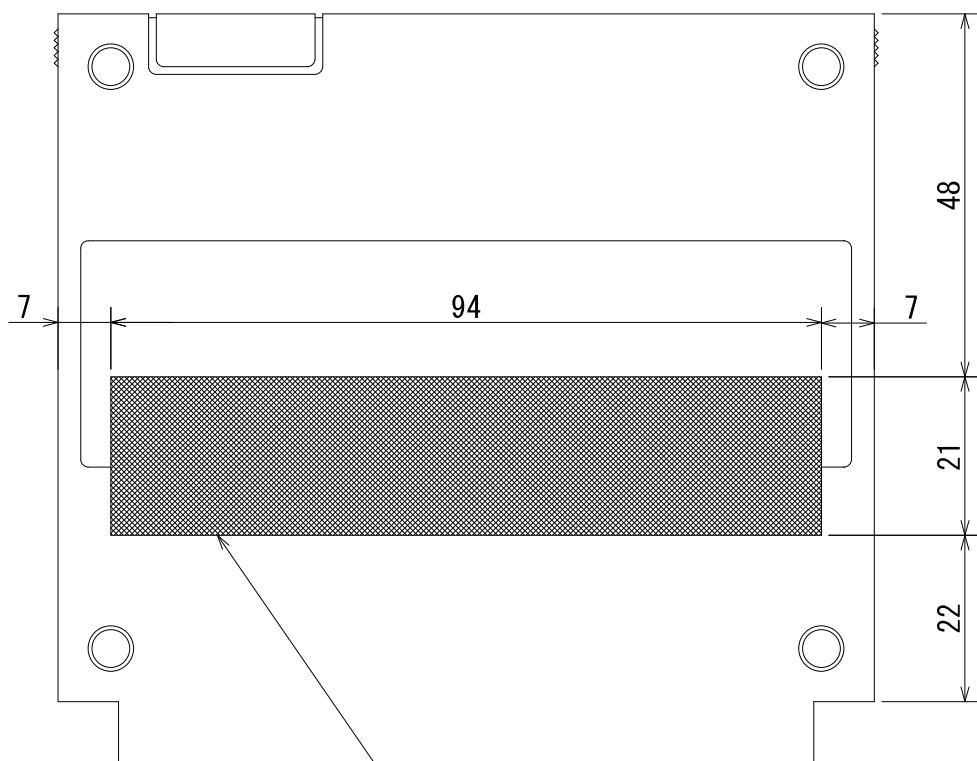
注1) ケースを取り付けた状態でディップスイッチを操作する必要がある場合は破線枠部分(※1)を開けること。



TNS-HFC3組込用カセット加工図

(単位：mm)

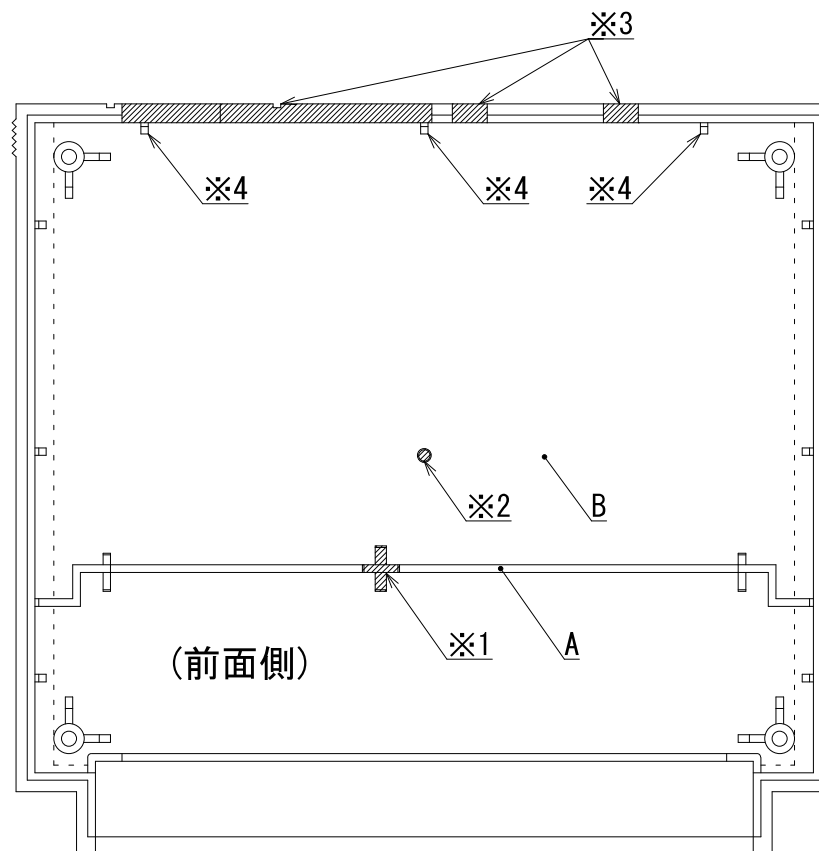
【外形加工図 ②】



網掛部分を削ること
(スロット非搭載モデルを除く)

【内側加工図】

前面側(タイトルシール貼付側)のみ加工



- 注1) 斜線部 ※1 は、A面の高さに合わせて削ること。
- 注2) 斜線部 ※2 は、B面の高さに合わせて削ること。
- 注3) 斜線部 ※3 は、外形加工図の指示に従って加工すること。
- 注4) ※4の箇所は、基板の組込の妨げにならないように削ること。